

<<手机维修技能与考证培训教程>>

图书基本信息

书名：<<手机维修技能与考证培训教程>>

13位ISBN编号：9787111313724

10位ISBN编号：7111313720

出版时间：2010-10

出版时间：机械工业

作者：梅秀江 编

页数：372

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<手机维修技能与考证培训教程>>

内容概要

本书采用了一种新型的“目标——任务——准备——行动——评估”五步训练法，即OPTPAE科学训练程序。

在每个能力点的训练中，均按照五步训练法组织教学和训练，具有内容丰富、资料翔实、图文并茂、直观易懂、实用性强的特点。

本书对手机维修入门与提高、行业服务、表面贴装元器件焊接工艺、常用仪器工具的使用技巧、典型机壳拆装技巧、手机整机三图(原理图、印制电路板图和实物图)的识读技巧、手机软硬件故障的判断与排除、技能鉴定与考核、应知应会一体化训练等有突出的指导作用。

本书可作为手机维修初、中、高级职业技能培训与考核的鉴定教材，也可作为中职学校、技工学校电子通信专业的一体化教材，还可用于高职高专学生的技能训练及职业资格考试用书，同时也是通信行业手机维修人员的自学用书，以及电子通信技术人员的参考用书。

<<手机维修技能与考证培训教程>>

书籍目录

前言本书教学(培训)大纲项目1 手机维修行业人员服务规范 任务1 前台服务 任务2 做好静电防护 任务3 职业素质培养项目2 识别与检测手机中的常用元器件 任务1 用万用表检测手机板中的贴片电阻器 任务2 用万用表检测手机板中的贴片电容器 任务3 用万用表检测手机板中的贴片电感器 任务4 用万用表检测手机板中的半导体二极管 任务5 用万用表检测手机板中的半导体晶体管 任务6 用万用表检测手机板中的半导体场效应晶体管 任务7 识别手机中的特殊元器件 综合技能训练1手机板中元器件实物的识别及测量项目3 拆焊手机板中的元器件 任务1 拆装常见手机机壳 任务2 贴片元器件拆焊技术之一——扁平元器件拆焊技术 任务3 贴片元器件拆焊技术之二——BGA芯片拆焊技术 综合技能训练2如何拆装封胶芯片及修复芯片焊盘项目4 手机中的通信技术基础 任务1 调频无线传声器组装 任务2 制作超外差接收机电路 任务3 组装与调试锁相环电路项目5 手机电路板中的元器件实物与功能图的对应 任务1 分析数码手机的功能图 任务2 分析手机中的电源电路设计形式 任务3 手机电路板中的元器件实物与功能图的对应项目6 测量手机中的信号 任务1 手机维修中稳压电源的使用 任务2 手机维修中示波器的使用 任务3 测量手机中的供电 任务4 手机维修中频率计及频谱仪的使用 任务5 测量手机中的射频信号项目7 手机识图及故障检修技巧项目8 手机整机电路分析与常见故障检修项目9 手机维修专业强化训练与考证项目10 手机电路中的专业英语翻译附录参考文献

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>